Pressemitteilung

**LANline Datacenter Symposium am 23.9.2021 in München: Technologieführer und Netzwerkspezialist tde ist Silber-Sponsor**

**Maximale tML-Packungseffizienz: tde zeigt das Rechenzentrum von morgen**

**Dortmund, 31. August 2021. Das diesjährige LANline Datacenter Symposium (DCS) findet am 23. September in München statt und vermittelt Rechenzentrums-Experten und -Betreibern unabhängiges, aktuelles Branchen-Know-how. Mit dabei ist der Dortmunder Netzwerkhersteller tde - trans data elektronik GmbH. Als Silber-Sponsor präsentiert der Technologieführer für die MPO-Mehrfasertechnologie und Anbieter innovativer modularer Verkabelungssysteme fundiertes Branchenwissen und nutzt diese Plattform für die Kommunikation seiner erfolgreichen tML-Standard-, tML24- und tML-Xtended-Systemplattformen, die bereits seit dem letzten Jahr auch mit LWL-MDC-Modulen verfügbar sind. Durch die Integration des kompakten MDC-Steckverbinders in die Systemplattform, die die tde als branchenweit erster Hersteller realisiert hat, verdoppelt sich die Packungsdichte im Patchbereich gegenüber LC-Duplex-Steckverbindern. Außerdem stellt die tde den überarbeiteten 19-Zoll tML-Modulträger für den Festeinbau vor, der neben einer verbesserten Funktionalität auch ein moderneres Design zeigt.**

Im Fokus des bevorstehenden LANline Datacenter Symposiums steht der moderne Datacenter-Betrieb. Themenschwerpunkte der Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden sind die Optimierung des Ressourcenverbrauchs, Entwicklungen bei Cooling und Klimatisierung, technischer Fortschritt bei USVs sowie PDUs, EN 50600 in der Praxis sowie internationale Normen, ganzheitliche Ansätze im Datacenter-Management, Wärmerückgewinnung und Umgang mit neuen Methoden der Stromerzeugung.

Gerade hinsichtlich Ressourcenverbrauch liefert die tde spannenden Input, denn Platz in Rechenzentren ist rar und wertvoll und sollte daher möglichst effizient geplant werden. Um den vorhandenen Platz bestmöglich zu nutzen und die Auslastung zu optimieren, hat die tde den von US Conec entwickelten kompakten MDC-Steckverbinder erfolgreich in ihre tML-Systemplattformen integriert: „Als Technologie-Pionier sowie langjähriger und vertrauensvoller Partner von US Conec kombinieren wir den Vorteil des sehr kompakten MDC-Steckverbinders mit unseren tML-Systemen. So können wir bereits heute als erster Hersteller überhaupt eine modulare Verkabelungsplattform basierend auf dem LWL-MDC-Modul anbieten und liefern. Damit unterstreichen wir unseren Anspruch als Innovationsführer“, sagt André Engel, Geschäftsführer der tde.

Ein weiteres Element der tML-Systemplattform präsentiert der Netzwerkspezialist in einer überarbeiteten Version: Der neue 19-Zoll tML-Modulträger mit einer Höheneinheit für den Festeinbau besitzt nicht nur einen stabileren Aufbau, sondern reduziert auch den Montageaufwand. „Das Design haben wir an den ausziehbaren Modulträger angelehnt“, so Engel. „So lässt sich nun auch hier die bekannte Abdeckung mit integrierter Patchkabel-Führung verwenden.“

*tML bietet zukunftssichere Lösung für gängige und künftige Steckverbinder*Unternehmen erhalten mit dem tML – tde Modular Link System eine bewährte und zuverlässige Systemplattform. Diese bindet im Patchbereich alle derzeit gängigen Steckverbinder ein, ist aber ebenso offen für künftige Steckgesichter. Möglich macht dies die spezielle Bauform der tML-Module. Die tde integriert den URM-kompatiblen RaMiCo Steckverbinder in ihre Systemplattform und setzt so auf ein bewährtes System. Er bietet 1,25-mm-Ferrulen in einem Stecker mit geringer Bauform. Das tML-System integriert auch die neuen CS- und SN-Steckverbinder von Senko sowie den neuen MDC-Steckverbinder von US Conec. In Kombination mit der tML-Systemplattform finden mit dem CS-Steckverbinder bis zu 256 Fasern, mit dem MDC-Steckverbinder 384 Fasern und mit dem
RaMiCo-Steckverbinder 192 Fasern auf einer Höheneinheit Platz. Auf diese Weise lässt sich der Platzbedarf in Rechenzentren bestmöglich optimieren.

**LANline Datacenter Symposium zum Thema**

**„Moderner Datacenter-Betrieb:**

**Das eigene RZ im Zusammenspiel mit Cloud, Hosting und Colocation”**

**23. September 2021**

**H4 Hotel München Messe**

**Konrad-Zuse-Platz 14, 81829 München**

**Weitere Informationen und Anmeldung unter:** <https://www.tde.de/de/events-details/lanline-datacenter-symposium-in-muenchen.html>

**Über die tde – trans data elektronik GmbH**
Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).
Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: [www.tde.de](http://www.tde.de/) sowie auf [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh/), [Twitter](https://twitter.com/tdeConnect) und [Xing](https://www.xing.com/companies/tde-transdataelektronikgmbh/updates).

**Unternehmenskontakt**tde – trans data elektronik GmbH, Vertriebsbüro Dortmund
André Engel, Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46, D - 44135 Dortmund
Tel. +49 231 160480, Fax +49 231 160933, info@tde.de, [www.tde.de](http://www.tde.de/)

**Pressekontakt**epr – elsaesser public relations, Maximilianstraße 50, D - 86150 Augsburg

Frauke Schütz, Tel: +49 821 4508 7916, fs@epr-online.de

Elke Thiergärtner, Tel: +49 821 4508 7912,et@epr-online.de

[www.epr-online.de](http://www.epr-online.de)